VDE-BEZIRKSVEREIN DRESDEN / VDI-DRESDNER BEZIRKSVEREIN

Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer
bauer@et.htw-dresden.de

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann
oppermann@zmp.et.tu-dresden.de
Dipl.Ing. Dietmar Daniel
daniel@et.htw-dresden.de

Informationen im Internet: *www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/*

SACHSEN VDE / VDI Sächsischer Arbeitskreis Elektronik-Technologie

49. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie

Datum: Mittwoch, 14. März 2007 10:00 Uhr - 16:00 Uhr

Thema: **Vom Halbleiter zur Baugruppe**

Gastgeber: Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG

Leitung: Herr Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer,
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, FB Elektrotechnik
Herr Dr. Böttcher,
Qimonda Dresden, Backend Technologie / Module

Agenda:

Eröffnung des Treffens
Prof. Bauer, Dr. Oppermann, Dr. Böttcher

Qimonda Dresden - Firmen Präsentation
Dr. Biedermann, Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG

Die Baugruppe "Computer-Hauptspeicher"
Hr. Hintz, Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG

Zukünftige Herausforderungen für DRAM-Produkte
Dr. Grafe, Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG

Modellierung parasitärer Effekte in der 3D-Systemintegration
Prof. Dr.-Ing. Günter Elst / Hr. Schneider,
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen -
Institutsteil Entwurfsautomatisierung

Einfluss von Poren auf die Zuverlässigkeit in CSP-Lötverbindungen
Dr. Ahrens, Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie ISIT

Aktuelle Informationen zur EU- und „China-RoHS“
Dr. Reiss, Qimonda Dresden GmbH & Co. OHG

Zuverlässigkeitsbetrachtungen der Leiterplattenoberfläche chemisch NiP/Au
Herr Ralf Schmidt, Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin

nanoEVA – Eine neue Plattform der Zusammenarbeit zwischen dem Fraunhofer IZFP-D und dem ZµP der TU Dresden
Dr. Henning Heuer, IZFP Dresden

Diskussion

Ende der Veranstaltung gegen 16:15 Uhr